

珠海自动化芯片测试哪里好

发布日期：2025-10-29 | 阅读量：35

探针台 1) 晶圆检测需具备多套视觉精密测量及定位系统，并具备视觉相互标定、多个坐标系互相拟合的功能；2) 探针台精度要求非常严苛，重复定位精度要求达到0.001mm(微米)等级；3) 探针台对设备工作环境洁净度要求较高，除需达到几乎无人干预的全自动化作业，对传动机构低粉尘提出要求，还需具备气流除尘等特殊功能。4) 晶圆检测对于设备稳定性要求较高，各个执行器件均需进行冗余度的控制，晶圆损伤率要求控制在1ppm(百万分之一)以内；拥有20+年的芯片行业经验。珠海自动化芯片测试哪里好

芯片测试座，用于IC封装后的测试，主要包含有互相组配的一上盖板与一基座。上盖板的内部容设有通孔，以及在邻近前述的通孔附近设置有复数个测试探针，用以接触IC各测试探针的内部容设有测试弹簧。基座的内部容设至少一承靠座，对应于上盖板的通孔，用以承载待测IC承靠座下方与基座之间设有至少一承靠弹簧，并且通孔与承靠座之间的距离小于IC封装后的厚度，且承靠弹簧的弹性系数大于上述复数个测试弹簧的弹性系数的总和。使用IC测试座的好处：1) 可避免待测IC于测试装置测试时因尺寸不合而被压损。2) 可避免因测试装置与待测IC接触不良而造成测试失败。3) 以提升测试良率及降制造成本。上海高端定制芯片测试流程公司拥有先进的芯片测试设备及专业的服务团队。

集成电路产业从上世纪60年代开始逐渐兴起，早期企业都是IDM运营模式（垂直整合），这种模式涵盖设计、制造、封测等整个芯片生产流程，这类企业一般具有规模庞大、技术全、积累深厚的特点，如Intel三星等。随着技术升级的成本越来越高以及对IC产业生产效率的要求提升，促使整个产业逐渐向垂直分工模式发展。1987年，台积电创立，将IC制造从IC产业中剥离出来，而后逐渐发展为设计、制造、封装、测试分离的产业链模式。这种垂直分工的模式首先较大提升了整个产业的运作效率；其次，将相对轻资产的设计和重资产的制造及封测分离有利于各个环节集中研发投入，加速技术发展，也降低了企业的准入门槛和运营成本；再者，各环节交由不同厂商进行，增强企业的专业性和生产流程的准确性。此外，专业测试从封测中分离既可以减少重复产能投资，又可以稳定地为中小设计厂商提供专业化测试服务，以规模效应降低产品的测试费用，缩减产业成本。

封装与测试的定义►封装Package将晶圆厂生产的芯片、塑料、陶瓷、金属外壳包装起来，以保护芯片在工作时不受外界的水气、灰尘、静电等影响，封装的材质必须考虑成本与散热的效果。►测试Test将制作好的芯片进行点收测试，检验芯片是否可以正常工作，以确定每片晶圆的可靠度与良率，通常封装前要先测试，将不良的芯片去除，只封装好的芯片，封装后还要再测试，以确定封装过程是否发生问题。封装后测试是出厂前的测试工作，另外包括脚位扫描检

查、品管抽样测试等，通过测试的IC就可以出厂销售了。 芯片测试是IC行业必不可少的步骤。

packagetest是在芯片封装成成品之后进行的测试。由于芯片已经封装，所以不再需要无尘室环境，测试要求的条件大幅度降低。一般packagetest的设备也是各个厂商自己开发或定制的，通常包含测试各种电子或光学参数的传感器，但通常不使用探针探入芯片内部（多数芯片封装后也无法探入），而是直接从管脚连线进行测试。由于packagetest无法使用探针测试芯片内部，因此其测试范围受到限制，有很多指标无法在这一环节进行测试。但packagetest是Z终产品的测试，因此其测试合格即为Z终合格产品。 芯片测试工序是半导体集成电路制程的非常重要的一道工序。 昆山MCU芯片测试诚信推荐

芯片测试是指在芯片生产出来之后利用ATE对芯片功能进行的一种物理检查。珠海自动化芯片测试哪里好

芯片是先导性、基础性产业，涉及国家信息安全，做大做强集成电路产业已成为国家产业转型的战略先导。近年来，中国集成电路技术水平与国际差距不断缩小，产业已经进入快速发展的轨道，其中主要包括以华为海思、紫光展锐等为中心的芯片设计公司，晶圆代工制造商（例：中芯国际、上海华虹），以及以华天科技、长电科技、通富微电等为大型的芯片封装测试企业，此外还包括采用IDM模式的华润微电子、士兰微等。构筑完成的产业生态体系具备实现集成电路专门用的设备进口替代并解决国内较大市场缺口的基础。我国垂直分工模式的芯片产业链初步搭建成形，产业上中下游已然打通，涌现出一批实力较强的代表性本土企业。珠海自动化芯片测试哪里好